

Halbleiterwerk Reutlingen

Oktober 2021

PI 11317 BBM Fi/af

- ▶ Fertigungsanlagen
 - 150-Millimeter-Technologie seit 1995
 - 200-Millimeter-Technologie seit 2010
 - Testzentrum für Halbleiter
 - Im Halbleiterwerk in Reutlingen werden seit 1970 Halbleiter (Integrierte Schaltungen) gefertigt.
- ▶ Reinraumfläche
 - 36 000 m²,
 - weitere 3 000 m² bis Ende 2023
- ▶ Mitarbeiter
 - 3 500
- ▶ Fertigungstechnologie
 - 150- und 200-mm-Siliziumsubstrate (Wafer) mit Strukturbreiten bis 180 nm; 1 nm ist ein Millionstel Millimeter
 - 150-mm-Siliziumkarbidsubstrate (Wafer) mit Strukturbreiten bis 400 nm
- ▶ Gefertigte Produkte
 - Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs), mikroelektromechanische Systeme (MEMS), Leistungshalbleiter
- ▶ Einsatzgebiete der Halbleiter
 - Automobilelektronik: Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP, elektronische Steuerungen für Verbrennungs- und Elektromotoren sowie Getriebe, Airbag- und Fahrerassistenzsysteme, Einparkhilfe, Nachtsichtsysteme
 - Konsumentenelektronik: Smartphones, Laptops, Wearables, Hearables, Spielekonsolen, Drohnen